

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**SOLOMON  
SYSTECH**

**SOLOMON SYSTECH (INTERNATIONAL) LIMITED**

**晶門半導體有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：2878)

## 盈利警告

本公告乃由晶門半導體有限公司（「本公司」），連同其附屬公司統稱作「本集團」根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.09(2)(a)條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部的內幕消息條文（定義見上市規則）而作出。

本公司董事會（「董事會」）謹此知會本公司股東及潛在投資者，根據本集團截至2024年6月30日止六個月的未經審核綜合管理賬目初步審閱以及董事會目前可得資料，本集團預期截至2024年6月30日止六個月將錄得未經審核股東應佔綜合溢利約7.0百萬美元至7.5百萬美元，較截至2023年6月30日止六個月約13.2百萬美元減少約43%至47%。未經審核股東應佔綜合溢利於2024年上半年減少的主要原因為銷售收入及毛利減少。因高通脹影響，消費性電子產品需求未見回復，另外，電子貨架標籤現處於由三色技術(E4)過渡至四色技術(E5)的過程，本集團於2024年上半年以相對較低售價策略性地對E4 IC進行庫存清理。以上是導致本集團產品平均售價降低的主要原因。

儘管未經審核股東應佔綜合溢利有所下降，且2024年上半年的E4 IC的平均售價較2023年上半年亦有所下降，惟董事會強調，本集團於2024年上半年仍能錄得較2023年下半年相比較佳的未經審核股東應佔綜合溢利，這主要是由於產品開發策略獲得優化，尤其是在大型顯示及PMOLED領域；本集團因此能夠維持穩定的IC付運增長（相對2023年下半年）。

本公司仍在擬定本集團截至2024年6月30日止六個月之中期業績。本公告所載列之資料僅為基於董事會對本集團截至2024年6月30日止六個月之最新及尚未經本公司獨立外聘核數師審閱或審核，亦未經董事會審核委員會審閱之未經審核綜合管理賬目所作之初步評估。本集團截至2024年6月30日止六個月之未經審核綜合中期業績可能需作進一步調整，並可能與本公告所載資料有所不同。本集團財務資料之進一步詳情預期將於2024年8月底前公佈之本公司截至2024年6月30日止六個月之中期業績公告中公佈。本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

承董事會命  
晶門半導體有限公司  
行政總裁  
王華志

2024年7月15日

於本公告刊發日期，董事會由(a)執行董事－王華志先生(行政總裁)；(b)非執行董事－馬玉川先生(主席)、王輝先生及劉斐女士；及(c)獨立非執行董事－陳志光先生、陳正豪博士及郭海成博士組成。